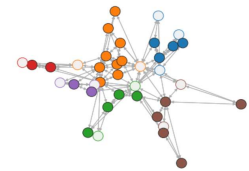


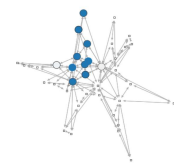
spillover

(1) 2018年 多核心-多外围
结构可视化



显著性检测可视化 (0.01)

显著性检测可视化 (0.01)



通过显著性测试的结构的P值
3.20E-05

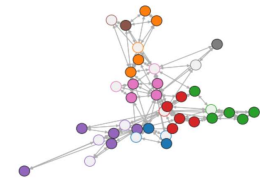
显著性检测可视化 (0.05)



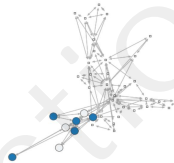
通过显著性测试的结构的P值
0.000365

核心节点	外围节点
Sony	Toyota
Monolithic	Western Digital
Micron	
Cypress	
Samsung Electronics Co Ltd DRC	
Intel	
Qualcomm	
Sanken	
Fuji Electric	

(2) 2019年 多核心-多外围
结构可视化

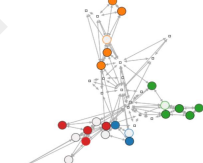


显著性检测可视化 (0.01)



通过显著性测试的结构的P值
0.000904883

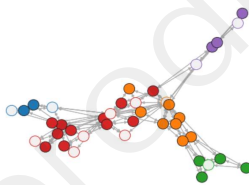
显著性检测可视化 (0.05)



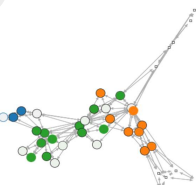
通过显著性测试的结构的P值
0.001917 0.0060149 0.001294191 0.001792

核心节点	外围节点
Nvidia	Micron
Western Digital	Diodes
ON Semi	Skyhynix
Fuji Electric	
Maxim Power Corp. (MXG)	

(3) 2020年 多核心-多外围
结构可视化

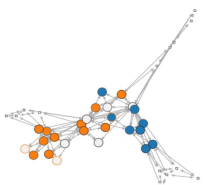


显著性检测可视化 (0.01)



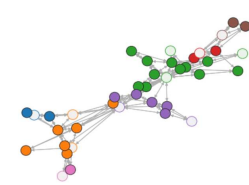
通过显著性测试的结构的P值
0.00073224 0.000344 0

显著性检测可视化 (0.05)

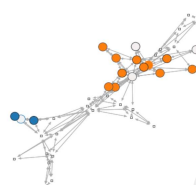


通过显著性测试的结构的P值
3.22E-05 0

(4) 2021年 多核心-多外围
结构可视化



显著性检测可视化 (0.01)



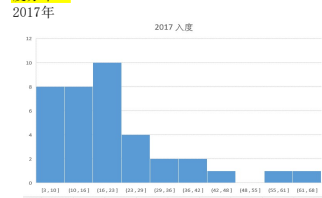
通过显著性测试的结构的P值
0.001155126 0

显著性检测可视化 (0.05)

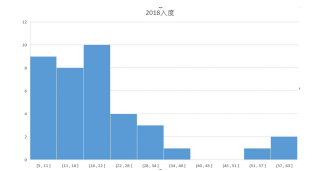


通过显著性测试的结构的P值
0.001096 0 0.00138299 0.00579

度分布



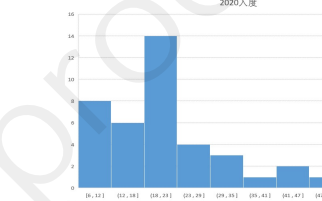
2018年



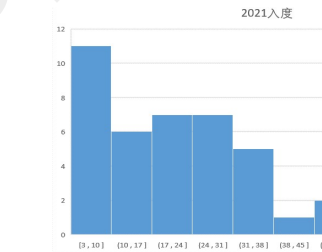
2019年



2020年

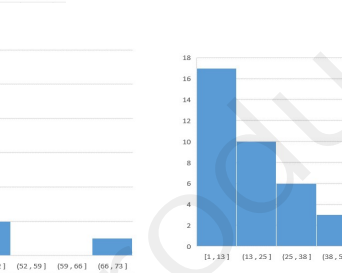
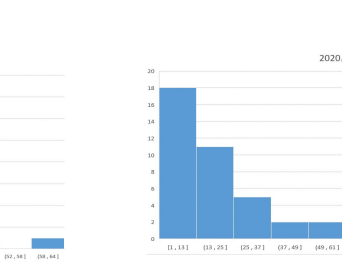
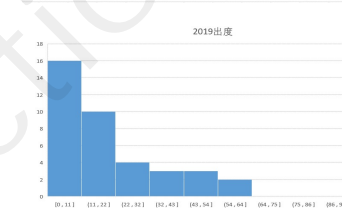
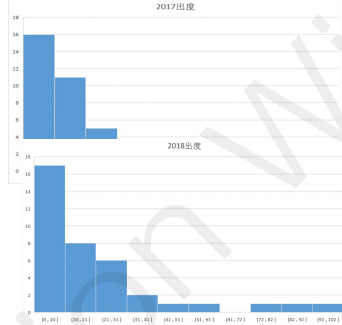


2021年



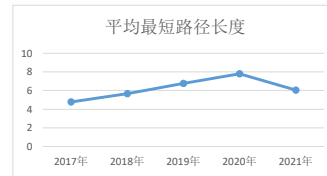
同配系数

	无向	出度-出度	出度-入度	入度-入度	入度-出度
2017年	0.0419	-0.016726	0.041937	0.10893	0.04194
2018年	-0.162	-0.143452	-0.143452	-0.12464	-0.14345
2019年	-0.017	-0.066571	-0.017191	0.02792	-0.01719
2020年	-0.113	-0.142033	-0.11309	-0.0846	-0.11309
2021年	-0.069	-0.107543	-0.068614	-0.02892	-0.06861



平均最短路径长度

	平均最短路径长度
2017年	4.77794
2018年	5.64816
2019年	6.74584
2020年	7.78464
2021年	6.04208



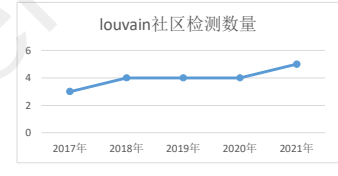
平均聚类系数

	平均聚类系数
2017年	0.10456
2018年	0.17604
2019年	0.11301
2020年	0.1797
2021年	0.09403

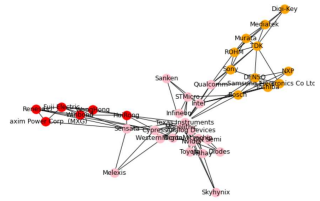


louvain社区检测 (数量)

	louvain社区检测 (数量)
2017年	3
2018年	4
2019年	4
2020年	4
2021年	5



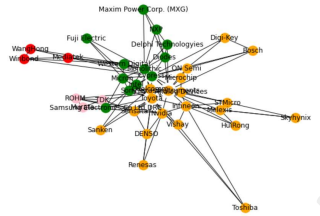
2017年



群体度中 群体介数 群体亲近中心性

Microchip', 'Qualcomm', 'Sensata', 'Melexis', 'Diodes', 'Skyhynix', 'Analog Devices', 'Toyota', 'Nvidia', 'Infineon', 'STMicro', 'Cypress', 'Micron', 'Western Digital', 'Vishay', 'ON Semi', 'Intel', 'Monolithic', 'Texas Instruments', 'Sanken'
'Samsung Electronics Co Ltd DRC', 'Digi-Key', 'Bosch', 'NXP', 'Toshiba', 'ROHM', 'TDK', 'DENSO', 'Murata', 'Mediatek', 'Sony'
Maxim Power Corp. (MXG)', 'Renesas', 'WangHong', 'Fuji Electric', 'Winbond', 'HuiRong'

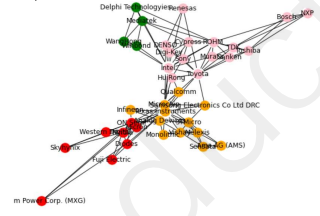
2018年



群体度中 群体介数 群体亲近中心性

'TDK', 'ROHM', 'Murata'
Analog Devices', 'Qualcomm', 'Sensata', 'Bosch', 'Skyhynix', 'Nvidia', 'Toshiba', 'Sanken', 'Renesas', 'Texas Instruments', 'STMicro', 'Infineon', 'Melexis', 'ON Semi', 'Toyota', 'Microchip', 'Vishay', 'DENSO', 'HuiRong', 'Digi-Key'
Mediatek', 'WangHong', 'Winbond'
Diodes', 'Delphi Technologies', 'Cypress', 'Intel', 'Maxim Power Corp. (MXG)', 'NXP', 'Samsung Electronics Co Ltd DRC', 'Micron', 'Fuji Electric', 'Monolithic', 'Western Digital', 'Sony'

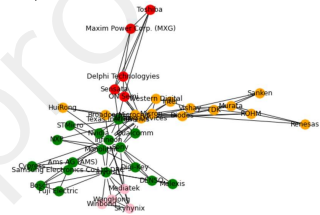
2019年



群体度中 群体介数 群体亲近中心性

'ROHM', 'NXP', 'DENSO', 'Cypress', 'Intel', 'Digi-Key', 'Sanken', 'Toyota', 'TDK', 'Bosch', 'Toshiba', 'Renesas', 'Murata', 'HuiRong', 'Sony'
'Analog Devices', 'Melexis', 'Qualcomm', 'Monolithic', 'Sensata', 'Samsung Electronics Co Ltd DRC', 'Texas Instruments', 'Infineon', 'Vishay', 'Ams AG (AMS)', 'STMicro', 'Microchip'
'Diodes', 'Nvidia', 'Micron', 'ON Semi', 'Western Digital', 'Skyhynix', 'Fuji Electric', 'Maxim Power Corp. (MXG)'
'Winbond', 'WangHong', 'Delphi Technologies', 'Mediatek'

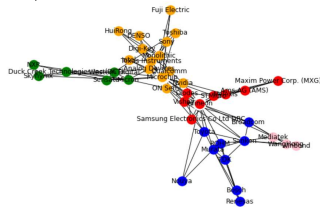
2020年



群体度中 群体介数 群体亲近中心性

'Mediatek', 'Skyhynix', 'WangHong', 'Winbond'
'TDK', 'HuiRong', 'Vishay', 'Sanken', 'Micron', 'ROHM', 'Diodes', 'Analog Devices', 'Renesas', 'Broadcom', 'Microchip', 'Murata', 'Intel', 'Western Digital'
'ON Semi', 'Toshiba', 'Maxim Power Corp. (MXG)', 'Delphi Technologies', 'Sensata'
'Melexis', 'Texas Instruments', 'Toyota', 'Cypress', 'Bosch', 'Samsung Electronics Co Ltd DRC', 'Nvidia', 'NXP', 'Monolithic', 'STMicro', 'Infineon', 'Sony', 'DENSO', 'Digi-Key', 'Fuji Electric', 'Ams AG (AMS)', 'Qualcomm'

2021年



群体度中 群体介数 群体亲近中心性

'Winbond', 'WangHong', 'Mediatek'
'Toshiba', 'ON Semi', 'Monolithic', 'Digi-Key', 'HuiRong', 'Fuji Electric', 'Intel', 'Qualcomm', 'Sony', 'Texas Instruments', 'Microchip', 'Analog Devices', 'Nvidia', 'DENSO'
'Diodes', 'Infineon', 'STMicro', 'Maxim Power Corp. (MXG)', 'Vishay', 'Ams AG (AMS)', 'Melexis', 'Samsung Electronics Co Ltd DRC'
'Skyhynix', 'Micron', 'Duck Creek Technologies Inc (DCT)', 'Western Digital', 'NXP', 'Sensata'
'Sanken', 'Renesas', 'TDK', 'ROHM', 'Nouya', 'Toyota', 'Broadcom', 'Murata', 'Bosch'